

研究報告書（第4報～第33報）の発行

中部エレクトロニクス振興会では、わずかながらでも皆様の技術的支援のできることを願い、共通の技術的問題の解決のために技術委員会において名古屋市工業研究所電子情報部と共同研究を進めています。

その研究成果を昭和60年より下記のとおり現在まで随時とりまとめ、研究報告書として発行してまいります。

これらの研究報告書は、貴社の技術に寄与し得る資料となるものと確信しておりますので、ご購入方お勧めいたします。

報告書No.	タイトル	発行	価格 (会員※)	価格 (非会員)
第4報	実装印刷配線板信頼性に関する研究 振動に関する研究	H 3. 3.	2,200	3,300
第5報	実装印刷配線板信頼性に関する研究 コネクタのはんだクラックの研究	H 3.11.	2,200	3,300
第6報	実装印刷配線板信頼性に関する研究 効率的な熱衝撃試験法に関する研究	H 4. 3.	2,200	3,300
第7報	実装印刷配線板信頼性に関する研究 表面実装印刷配線板に関する研究	H 4. 3.	2,200	3,300
第8報	実装印刷配線板信頼性に関する研究 洗浄に関する研究	H 5. 6.	2,200	3,300
第9報	実装印刷配線板信頼性に関する研究 無洗浄化による脱フロンの研究	H 7. 1.	2,200	3,300
第10報	実装印刷配線板信頼性に関する研究 温度変化と湿度による加速試験に関する研究	H 7. 3.	2,200	3,300
第11報	実装印刷配線板信頼性に関する研究 表面実装配線板はんだ部のき裂に関する研究	H 8. 8.	2,200	3,300
第12報	実装印刷配線板信頼性に関する研究 無洗浄化による脱フロンの研究	H 8.10.	2,200	3,300
第13報	実装印刷配線板信頼性に関する研究 無洗浄化による脱フロンの研究	H 9. 9.	2,200	3,300
第14報	実験報告書(ランダム振動試験に関する研究) H4.4～H7.3.	H 7. 4.	1,100	1,100
第15報	振動試験に関する実験報告書 (振動の加速度・周波数・頻度の3次元表現)H7.4～H10.3	H10. 4.	1,100	1,100
第16報	静電気破壊に関する研究報告書 －人体静電気放電によるIC破壊－	H11. 3.	1,100	2,200
第17報	実装印刷配線板信頼性に関する研究 部品実装に関する研究	H11.10.	2,200	3,300
第18報	鉛フリーはんだの手はんだ付け信頼性	H13.10.	2,200	3,300
第19報	実装印刷配線板信頼性に関する研究 はんだバンプ接合部(CSP)の落下衝撃信頼性に関する研究	H13.10.	2,200	3,300
第20報	電子機器の電磁ノイズ対策に関する研究 放射イミュニティの定量的評価に関する研究	H13.10.	1,100	2,200
第21報	電子機器の電磁ノイズ対策に関する研究 電子機器巨体開口部のGHz帯電磁シールド性能に関する実験的検討	H16. 3.	1,100	2,200

第 22 報	電子機器の熱設計に関する研究～簡易温度予測式の検討～	H16. 11.	2, 200	3, 300
第 23 報	鉛フリーはんだの接合信頼性に関する研究 はんだぬれ性および耐衝撃性に関する実験的検証	H16. 11.	1, 100	2, 200
第 24 報	実装印刷配線板信頼性に関する研究 鉛フリーフローはんだのはんだ付け性の信頼性	H17. 5.	1, 100	2, 200
第 25 報	鉛フリーはんだの接合信頼性に関する研究 実装外観品質基準の適切性に関する評価	H20. 3.	2, 200	3, 300
第 26 報	電子機器の熱設計に関する研究 ～シミュレーションモデルの簡略化に関する検討～	H20. 10.	1, 100	2, 200
第 27 報	鉛フリー実装後の信頼性に関する研究 ～ウイスカに関する研究～	H22. 10.	2, 200	3, 300
第 28 報	電子機器の熱設計に関する研究 ～シミュレーションモデルの簡略化に関する検討Ⅱ～	H23. 11.	2, 200	3, 300
第 29 報	鉛フリー実装後の信頼性に関する研究 低銀鉛フリーはんだの接合信頼性に関する研究	H27. 3.	2, 200	3, 300
第 30 報	画像応用システム開発に関する研究 手話認識を題材とした画像処理技術の蓄積	H27. 10.	1, 100	2, 200
第 31 報	電子機器の熱設計に関する研究 ～トロイダルコイルの熱解析モデル～	H29. 2.	2, 200	3, 300
第 32 報	GHz帯差動伝送に関する研究 ～高速伝送路の信号品質改善と電磁ノイズ低減に関する研究	R1. 11	4, 400	5, 500
第 33 報	電子機器の熱設計に関する研究 ～放熱シートの熱解析モデル～	R4. 1	2, 200	3, 300

※会員：中部エレクトロニクス振興会に入会している企業 ※価格は消費税込

1. 申込・支払方法

- ・下記申込書にご記入の上、E-mail、FAXにてお送り下さい。
- ・申込書が届き次第、報告書と請求書をお送りいたしますので、後日振込みでお支払下さい。

2. 申込・問合せ先

中部エレクトロニクス振興会 事務局

〒456-0058 名古屋市熱田区六番 3-4-41

Tel : (052) 661-6476

Fax : (052) 651-5460

E-mail : cea@eleshin.org

キ リ ト リ

月 日

研究報告書 購入申込書			
報告書No.		冊数	
会社名			
住所	〒		
所属部・課		氏名	
電話		E-mail	
受取方法	<input type="checkbox"/> 事務局にて購入 / <input type="checkbox"/> 郵送を希望 (郵送料¥550 税込)		

↑○をお付け下さい。